



# AARON ZIELSTORFF

Elektrotechniker | Softwareingenieur

@ aaron@zielstorff.com

+49-30-62963482

+49-177-2847470

Ahornallee 16, 12555 Berlin, Deutschland

09. August 1998

aaron-zielstorff

aaronzi

0009-0001-2476-8415

aaronzi

## TECH STACK

JavaScript

C#

Java

Python

PHP

C/C++

MATLAB

HTML

CSS

Vue.js

.NET Framework

Maven

BaSys

Milo

NumPy

PyTorch

Git

Docker

NGINX

OpenAPI

Linux

Windows

macOS

MySQL

MongoDB

Firebase

PHPMyAdmin

Visual Studio

Shell

Visual Studio Code

IntelliJ IDEA

Eclipse IDE

HTTP/REST

MQTT

OPC UA

Modbus

CAN Open

Profnet

## WEITERES

MS Office

MS Outlook

MS Visio

MS Teams

Enterprise Architect

CoDeSys

TIA-Portal

AI-Driven Development

Adobe Illustrator

LaTeX

Asset Administration Shell

Blender

Adobe XD

## ÜBER MICH

Als Full-Stack Softwareentwickler und Elektrotechniker (Fachrichtung Automatisierungstechnik) verfüge ich über fundierte Expertise in den Bereichen Digitalisierung der Industrie und Enterprise-Applikationen. Mein Fokus liegt auf der Erforschung und Implementierung des Digitalen Zwillings und dessen standardisierte Form, die Asset Administration Shell (AAS).

## BERUFSERFAHRUNG

### Wissenschaftlicher Mitarbeiter | HTW Berlin

10 2023 – Heute

Berlin, Deutschland

- Projektleitung an der HTW für das BMBF-Förderprojekt *BaSys4Transfer* zur Entwicklung von Open-Source-Software zum Transfer von Industrie 4.0 Technologien in die Praxis (insbesondere KMU)
- Teilnahme an diversen Konferenzen und Workshops inklusive wissenschaftlicher Publikationen (Auszug siehe *Publikationen*)

### Software Entwickler | mobile only SI GmbH

08 2017 – Heute

Berlin, Deutschland

- Frontend Webentwicklung auf Basis von Vue.js für die Umsetzung von Webapplikationen (u.a. Dashboards, Webshops, Außendienstlösungen)
- Umsetzung von Enterprise-Applikationen in den Bereichen Customer Relationship Management (CRM), Marketing und Vertrieb

### Studentischer Mitarbeiter | HTW Berlin

03 2021 – 09 2023

Berlin, Deutschland

- Projektorganisation und Mitarbeit in den BMBF-Förderprojekten *OpenBaSys* und *BaSys4Transfer* zur Entwicklung von Open-Source-Software auf Grundlage der Verwaltungsschale
- Teilnehmer in der Arbeitsgruppe *Open Technology* und *AAS Quality Management* der Industrial Digital Twin Association (IDTA) zur Entwicklung von Standards für die Verwaltungsschale

### Lehrperson | HTW Berlin

10 2021 – 03 2023

Berlin, Deutschland

- Lehrperson für das Modul *Prozesssteuerungssysteme* im Studiengang Elektrotechnik
- Aufbereitung und Vermittlung von Lehrinhalten im Bereich der Automatisierungstechnik unter praktischer Anwendung von speicherprogrammierbaren Steuerungen

## SPRACHEN

Deutsch: **Muttersprache**

Englisch: **Fortg. / C1**


Französisch: **Grundl. / A2**

Latein: **Kleines Latinum**

## REFERENZENZEN


**Prof. Dr.-Ing. S. Schäfer**

 htwberlin


 Stephan.Schaefer@  
htw-berlin.de


**Dipl.-Ing. Dirk Schöttke**

 htwberlin


 Dirk.Schoettke@  
htw-berlin.de


**Sven Braun**

 mobile-only-si-gmbh

 s.braun@  
mobileonly.com


**Frank Schnicke**


 fraunhoferiese

 Frank.Schnicke@  
iese.fraunhofer.de

## AUSBILDUNG

M. Eng. Elektrotechnik | **HTW Berlin**

 10 2021 – 09 2023

 Berlin, Deutschland

- Note: 1,3 (mit Auszeichnung)

B. Eng. Elektrotechnik | **HTW Berlin**


 04 2018 – 09 2021

 Berlin, Deutschland

- Note: 1,5


## PROJEKTE

BaSyx AAS Web UI |  |  | 

 02 2022 – Heute

- Projektverantwortung für die Umsetzung der offiziellen BaSys-Middleware-Lösung zur Visualisierung von Verwaltungsschalen
- Über 140.000 Downloads von DockerHub (Stand 12 2023) sowie Anwender aus Industrie und Forschung (u.a. WAGO, Fraunhofer IESE, SICK AG)


OPC2AAS |  | 

 05 2023 – Heute

- Projektverantwortung für die Planung und Umsetzung eines Generators zur automatischen Erstellung von Verwaltungsschalen aus OPC UA Datenstrukturen
- Verantwortlicher für die Pflege der Lösung als BaSyx Off-the-Shelf-Architekturkomponente

## PUBLIKATIONEN

Overcoming Challenges in Integrating Legacy Devices with Asset Administration Shells - An OPC UA Case Study | 

 09 2023

- ETFA 2023 - 28th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
- DOI: 10.1109/ETFA54631.2023.10275536

Component Test - Test Strategies with Asset Administration Shells | 

 06 2023

- ISIE 2023 - 32nd IEEE International Symposium on Industrial Electronics
- DOI: 10.1109/ISIE51358.2023.10228026

Integration of PLC for synchronization of plant segments with Asset Administration Shells | 

 10 2022

- IECON 2022 - 48th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
- DOI: 10.1109/IECON49645.2022.9968774